

2023年度

研究発表会・シンポジウム等への助成応募要領

電子回路基板技術に関する基礎技術、応用技術及び生産技術の学会・研究会等が開催する研究発表会、シンポジウム等への助成応募は、本要領によって行われますので「申請される方への注意」と合わせて充分お含みのうえ、所定の申請書に正確に記載してください。

1. 助成の対象領域

電子回路基板技術に関する基礎技術、応用技術及び生産技術の学会・研究会等が開催する研究発表会、シンポジウム等を対象とし、その成果が電子回路基板技術の発展に貢献することが期待され得るものとします。

この場合、開催場所は、国内外を問いません。

2. 応募の資格

応募資格者は、次の機関・団体等とし、研究発表会、シンポジウム等の主催または共催者であることを要します。

- (1) 大学及び高等専門学校
- (2) 国公立等の研究機関
- (3) その他本財団で認めた機関・団体等

3. 助成の金額

50万円を基準としますが、内容、規模等によって減額することがあります。この助成金は、研究発表会等のための設営費、消耗品費等指定費目以外に使用することはできません。

4. 研究発表会等の開催時期

助成の対象となる研究発表会・シンポジウム等は、原則として次の期間内に開催されるものとします。

2024年4月1日から2025年3月31日までの1年間

5. 助成対象者の選定

助成対象者の選定は選考委員会における厳正な審査を経てその採否を決定し、2024年2月下旬までに申請者宛に採否通知します。

なお、採択後、申請時と異なる事態を生じた場合は、採択が取り消されることもありますので充分注意してください。

6. 研究発表会等の終了報告

研究発表会、シンポジウム等の最終日から 2 ヶ月以内に、所定の報告書を必ず提出しなければなりません。

7. 開催及び成果の公表

研究発表会、シンポジウム等の開催にあたっては「案内書等に本助成がある旨を公表」し、またその成果を「機関誌等の文書によって公表」することが強く望まれます。

その公表の際は、その旨記載した案内書、機関誌等を必ず 1 部、速やかに本財団宛提出してください。

本財団のホームページ等で報告の概略を実績情報として公開します。

8. 申請書の提出期間（期限）

2023 年 10 月 1 日から同年 11 月 15 日までの 1.5 ヶ月間

上記期間外の受付は致しませんので、期限を厳守してください。

9. 申請書の提出先

〒163-1388

東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 4 3 階
一般財団法人電子回路基板技術振興財団
事務局

10. 問合せ先

一般財団法人電子回路基板技術振興財団
事務局

Tel : 080-3569-2511

E-mail : jimukyoku@ecb-zaidan.or.jp

URL : <http://www.ecb-zaidan.or.jp>

以上